

臻鼎 2026 年上半年營收、毛利率雙創同期新高

AI 產品組合升級帶動獲利提升，業界最大規模擴產打造下一階段成長動能

全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)今(11)日召開法說會，公佈 2026 年第二季暨上半年合併財務報告。受惠高階 AI 應用需求快速成長，上半年營收達新台幣 891.59 億元，年增 13.9%，再創歷年同期新高；稅後淨利為新台幣 57.74 億元，歸屬母公司淨利為新台幣 38.17 億元，每股盈餘為新台幣 3.55 元。

臻鼎表示，隨 AI 相關高階產品需求持續放量，公司營收結構進一步優化。上半年伺服器／光模塊／IC 載板合計營收年增 113%，營收占比達 21.6%。隨高附加價值產品比重增加，上半年毛利率及營業利益率分別提升至 22.4%及 7.0%，顯示公司成長動能正由營收規模擴張，進一步轉化為獲利能力提升。

展望未來，臻鼎指出，AI 算力基礎建設持續深化，正推動高階 PCB 進入新一輪長期成長週期。隨客戶下一世代 AI 平台陸續量產，公司伺服器／光模塊業務自第二季起逐季增強，2026 年相關業務營收目標維持成倍成長。中長期而言，AI 需求將由伺服器與光模塊進一步擴展至 Edge AI 及人形機器人等終端應用，持續提升高階 PCB 的使用量、技術門檻與產品價值，公司對 2026-2030 年的成長深具信心。

以各產品應用而言，光模塊為成長動能最強勁的業務之一，由於 1.6T 及後續世代產品須採用 mSAP 技術，全球高階光模塊供給缺口高，臻鼎正積極擴大相關產能。公司預期，光模塊相關營收不僅將在 2026 年成倍成長，同時客戶已開始預訂 2027 年產能，公司目標 2027 年躍升為全球最大高階光模塊 PCB 供應商。在 AI 伺服器領域，GPU 與 ASIC 客戶之 Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品已陸續轉量產，相關產品進程依照既定計畫推進，目標後續份額持續提升。

為掌握高階 AI 應用帶來的長期成長機會，臻鼎正在推進業界規模最大的產能擴充計畫。臻鼎強調，由於高階 PCB 產能建置與客戶認證均需較長前置期，唯有糧草先行、提前布局，才能在客戶新平台進入量產時即時提供所需產能。公司 2026 年資本支出預計達新台幣 800 億元+，2027 年至 2028 年亦將維持較高投資水準，聚焦 iHDI／mSAP、HLC、IC 載板及高階軟板等高成長、高附加價值領域。公司目前共有 13 棟新廠建設中、16 棟新廠規劃中，新增產能將依客戶導入及量產進度，於 2026 至 2030 年間分階段開出，逐步將資本投入轉化為營收與獲利貢獻。

臻鼎亦於 2026 年 7 月 24 日在深圳舉辦全球供應商大會，匯聚 247 家供應商、超過 400 位代表與會。臻鼎表示，高階 PCB 技術、產能與品質的持續升級，仰賴設備、材料及各環節合作夥伴共同投入。公司將持續深化與全球供應鏈的長期合作，透過技術共創、資源共享與智慧製造協同，攜手打造 AI 應用所需的高階 PCB 產業生態系。

隨 AI 算力建設持續推進，高階 PCB 需求正由伺服器、光模塊擴展至各類邊緣 AI 終端。臻鼎憑

藉業界最完整的 PCB 技術布局、全球化產能及長期客戶合作基礎，將持續把握 AI 帶來的結構性成長機會。隨新增產能分階段開出、高階產品占比提升，臻鼎將進一步強化在全球 AI 關鍵供應鏈中的領先地位，推動營收規模與獲利能力同步成長，營運表現續創新高。

單位：新台幣百萬元，除每股盈餘外

期間	2Q26	2Q25	年變動	1H26	1H25	年變動
營業收入	48,431	38,203	+26.8%	89,159	78,285	+13.9%
營業毛利	11,186	7,011	+59.6%	19,998	12,896	+55.1%
營業利益	3,761	2,425	+55.1%	6,265	3,481	+80.0%
稅後淨利	3,727	1,387	+168.6%	5,774	2,413	+139.3%
歸屬母公司淨利	2,392	605	+295.3%	3,817	1,237	+208.5%
每股盈餘	2.19	0.63	+247.6%	3.55	1.30	+173.1%
毛利率	23.1%	18.4%	+4.7ppts	22.4%	16.5%	+5.9ppts
營業淨利率	7.8%	6.3%	+1.5ppts	7.0%	4.4%	+2.6ppts
純益率	7.7%	3.6%	+4.1ppts	6.5%	3.1%	+3.4ppts

詳細財報相關資訊請至公司網站「[投資人專區](#)」查詢。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2025 年連續九年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站：

www.zdtco.com。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com